



△6	△4	178308-5
△6	△3	178308-3
△6	△2	178308-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	

コネクタ外形  
OUTLINE OF HEADER HOUSING

20-φ1.1  
DIA 1.1±0.1 20 PLACES

スルーホール 2-φ3  
DIA 3±0.1 2 PLACES

ラウンド 2-φ4 MIN  
ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES

推奨基板取付け穴寸法  
PC 基板厚: 1.6±0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の土にスズめっき

				Copyright © 1993 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
C1	REVISED ECR-07-013273	TS DM	11/20/93	WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME ダイナミック D3100 水平タイプ 20 極 ヘッダーアセンブリー	
C	REVISED(FJD0-0039-03)	TS S.M	6/2/93	mm(AWG)	mm	20 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
B	REVISED(FJD0-0114-03)	TS SM	25/APR/93	MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
A	REVISED (FJ00-2183-95)	K.I SM	3/23/95	SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	100μm : ±0.3	SIZE LOC NUMBER
O	RELEASED (FJ00-0017-93)	Y.T S.M	2/8/93	DR. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	DE. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	100% 300μm : ±0.4	A3 J C-178308
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK DATE	CHK. 8-FEB-'93 S.MANABE	APP. 8-FEB-'93 S.MANABE	300μm 1000μm : ±0.45	SCALE REV SHEET
						角 度 : ±3'	2-1 C1 1 OF 1

PRINT DIST

AMP-J  
REV.10/83

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面